

2019年10月25日

「株式会社ホクシンエレクトロニクス」に対する協調融資について

～新工場の増設に対する「ふるさと融資」（貸付団体：秋田市）と秋田信用金庫の協調融資～

秋田信用金庫（理事長 平野敬悦）は、秋田市が貸付団体となる一般財団法人 地域総合整備財団（ふるさと財団）の「ふるさと融資」制度の対象事業者である株式会社ホクシンエレクトロニクス（代表取締役社長 佐藤宗樹）に対し協調融資を実施しましたので、お知らせいたします。

当金庫は、今後も地方公共団体が地域振興に資する民間投資を支援する「ふるさと融資」制度と連携し地域経済の活性化に努めてまいります。

1. 事業概要

今後の電子部品の受注環境（海外流出、新規設備導入等）の変化に対応するため、当社敷地内に新工場を増設することで、主に車載関連を扱う事業を集中させ既存事業の増産対応、新規事業の取込みを図ります。また、ものづくり環境が向上することで品質や労働衛生面の向上を図ります。将来的には当社がハブ企業となり、秋田市内の同業他社との連携を強化し、秋田市の更なる電子デバイス業の発展に貢献するものと考えます。

2. 協調融資概要

融 資 総 額：157百万円

ふるさと融資：107百万円（貸付団体：秋田市）

当金庫融資：50百万円

3. 株式会社ホクシンエレクトロニクスの概要

会 社 名：株式会社ホクシンエレクトロニクス

代 表 者：佐藤 宗樹

本社所在地：秋田県秋田市牛島東1丁目11-8

事 業 内 容：「半導体」「FPC（フレキシブル基盤）」「通信機器」等の開発および製造

以上

※本件についてのお問い合わせ先

秋田信用金庫 総合企画部 フリーダイヤル 0120-345-112